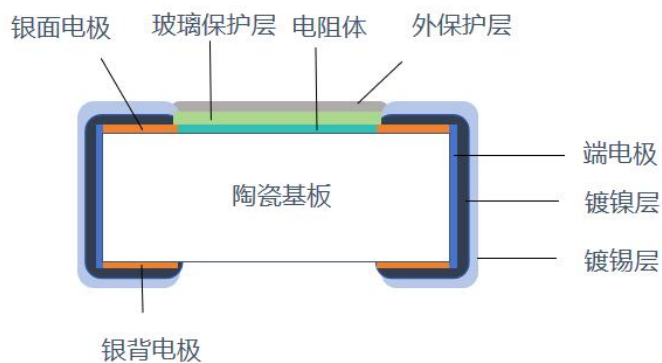


■ 片式电阻用银电极浆料

◆ 特征：

- * 银灰色膏状流体，主要由银粉、玻璃粉和有机粘合剂组成，不含铅、隔、铬等有害物质，符合 Rohs 环保要求。
- * 烧结后与瓷体结合紧密，附着力高，银层致密，导电率高。
- * 应用于片式电阻背电极和面电极制造。

◆ 产品在片式电阻中应用示意图及产品图片



面银和背银电极浆在片式电阻产品上的应用



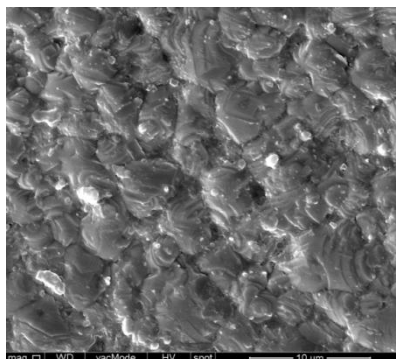
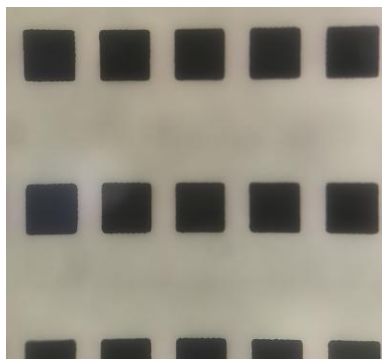
◆ 物理性能：

型 号	固含量 (%)	银含量 (%)	粘 度* (Pa·S)	细度 um (第二刻线/90%)	适用性
DD-1F	60.0±1.0	50.0±1.0	150.0±50.0	90%≤8.0	片式电阻背电极
DD-2F	48.0±1.0	40.0±1.0	200.0±40.0	90%≤8.0	片式电阻背电极
DD-3F	43.5±1.0	38.0±1.0	150.0±50.0	90%≤8.0	片式电阻背电极
AGD-0370	73.0±2.0	70.0±1.0	250.0±50.0	90%≤8.0	片式电阻面电极
AGD-0366	71.5±1.0	66.0±1.0	250.0±50.0	90%≤8.0	片式电阻面电极

(注*：粘度检测条件为 Brookfield HBDV-II +, CP52, 10.0rpm, 25±0.5℃)

◆ 产品特点：

- * 在氧化铝片上印刷效果图片及烧结后电镜图



- * 该浆料所用关键材料银金属粉体为我司自制，可以接受客户定制不同银含量浆料。

◆ 推荐工艺：

- * 搅 拌：使用前慢速搅拌均匀。
- * 封 端：用匹配的设备及技术参数进行封端。
- * 干 燥：链式烘炉（适量抽风）125~230℃(峰值温度)，8~15min（全程时间）。
- * 烧 结：推荐峰值温度及保温时间如下：

型号	烧结温度范围（℃）	保温时间（min）
DD-1F	850±10	8~12
DD-2F	850±10	8~12
DD-3F	850±10	8~12
AGD-0370	850±10	8~12
AGD-0366	850±10	8~12

◆ 产品使用注意事项

- * 电 镀：适用于氨基磺酸体系的电镀液。
- * 清 洗：建议使用无水乙醇清洗。
- * 储存条件：建议在温度 18~25℃、湿度≤75%环境密封储存，避免置于阳光直射或含有腐蚀性气体环境中。
- * 有 效 期：建议在符合上述储存条件下 6 个月内使用。
- * 包装规范：采用 PE 塑料瓶，500g/瓶或 1000g/瓶或 2000g/瓶。